

## 技术参数

# 5668E

日期：10/2025

## 应用介绍

### 特点

一款单组份环氧树脂胶，加热固化、低粘度、流平好，具有较高耐候性及稳定可靠性能；适用于电子芯片及元器件底部填充及保护。

### 粘接材料

金属，陶瓷，塑料，玻璃等

### 典型应用

电子芯片及元器件底部填充

## 固化前特性

| 特征          | 数值         | 测试方法                   |
|-------------|------------|------------------------|
| 化学名称        | 环氧树脂       |                        |
| 颜色          | 无色         |                        |
| 粘度(cps)     | 1968       | 20rpm@25℃, ASTM D-1084 |
| 密度(g/ml)    | 1.168      |                        |
| 固化条件*       | 20mins@80℃ |                        |
| 有效期@ -20℃,月 | 6          |                        |

\*固化温度是指达到胶水表面的实际温度

## 固化后特性

| 特征       | 数值                                    | 测试方法                 |
|----------|---------------------------------------|----------------------|
| 外观       | 无色                                    |                      |
| 邵氏硬度     | 80D                                   | ASTM D-2240          |
| 玻璃化温度 Tg | 100℃                                  | DSC, TA Q20, 40℃/MIN |
| 折射率      | 1.51                                  |                      |
| CTE      | a1=37ppm/℃ (<Tg)<br>a2=200ppm/℃ (>Tg) |                      |

| 可靠性     | 数值        | 测试方法 |
|---------|-----------|------|
| 固化失重    | ≤2%       |      |
| 工作温度范围* | -55℃—150℃ |      |

## 5668E 不同温度下的粘度曲线



[www.stick1mat.com](http://www.stick1mat.com)

Email: [info@stick1mat.com](mailto:info@stick1mat.com)

上海老港工业区同发路 123 弄 12-1 号



### 储存和使用方法

产品需低于-20℃环境中保存，使用前请先移至室温解冻，30ml 包装至少回温 2 小时。使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考 SDS 文件；

### 注：

1. 本技术数据表(TDS)中提供的信息和应用建议是基于截至 TDS 更新日时，我们对本产品的了解和经验而编写，数据不作为质检标准。该产品可以有各种不同的应用，差异化的应用和工作环境会超出我们的控制范围，因此我们对产品的适用性不承担责任，强烈建议您在使用前做完整的产品和工艺匹配测试，并以此来评估确认该产品的适用性。
2. 本文档的内容可能会有更新，除非有明确的书面承诺，禧合没有义务通知用户关于内容的更改。

